

Profil ID: C7LCK3DFLQ

Wohnort des Spezialisten: Deutschland, 01445

Mikroelektronik Packing, Materials

Mitarbeiterprofil

EUROPÄISCHER LEBENS LAUF

Angaben zur Person

Staatsangehörigkeit		Deutsch
Jahrgang		1948

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen

Muttersprache		Deutsch
Sonstige Sprachen		
• Lesen		Englisch
• Schreiben		Englisch
• Sprechen		Englisch
• Lesen		Russisch (teilweise)
Soziale Fähigkeiten und Kompetenzen		Zertifizierte Trainings zu: - Technische Experten Laufbahn - Projektleitung - Konfliktbewältigung - Mitarbeiterführung - Sprachkompetenz
Spezielle Organisatorische Fähigkeiten und Kompetenzen		- Langjährige Projektleitererfahrungen für F&E-Projekte - Entwicklung von Montagetechnologien/Gehäusen für

		Integrierte Schaltkreise und Speichermodule - Zentrale technisch-inhaltliche Verantwortung für die Verpackung und Prozeßhandlings Lösungen von Integrierten Schaltkreisen und Speichermodulen - Prozeßdokumentation und Prozeßänderungsmangagment
Technische Fähigkeiten und Kompetenzen		Zertifizierte Befähigungsnachweise für: - Projektleitung - Projektplanung/Steuerung mit MS-Project - AutoCad Mechanical - FMEA - DoE, Statistik - ESD Schutz
Sonstige Fähigkeiten und Kompetenzen		- Alle MS-Office Programme - Vertraut mit "Manufacturing Execution Systems" (MES-Datenbanken): Workstream, SAP/R3, DEAL, ATHOS, diversen LotusNotes Datenbanken
Führerschein		Klassen 1a,b,3,4,5 (PKW, LKW bis 7,5t, Krad)

Schul- und berufsbildung, Wehrdienst

• Datum (von – bis)		1970 - 1974
• Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung		Technische Hochschule, Institut für Chemie und Werkstofftechnik
• Bezeichnung der erworbenen Qualifikation		Dipl.-Ing. für Werkstoffkunde
• Datum (von – bis)		1968 – 1970
• Wehrdienst		Wehrpflicht
• Bezeichnung der erworbenen Qualifikation		Unteroffizier
• Datum (von – bis)		1965 – 1968
• Bezeichnung der erworbenen Qualifikation		Facharbeiter für Stahlerzeugung, Berufsausbildung mit Abitur
• Datum (von – bis)		1955 – 1965
• Name und Art der Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung		Polytechnische Oberschule
• Bezeichnung der erworbenen Qualifikation		Mittlere Reife

Arbeitserfahrung

• Datum (von – bis)		ab 09/2002
• Tätigkeitsbereich oder Branche		Backend(BE) Produktintegration, F&E und zentrale technisch-inhaltliche Verantwortung für die Verpackung und das Handling von IC und Speichermodulen bei Infineon/Qimonda
• Beruf oder Funktion		Staff Engineer (Graduation für Fachexpertenlaufbahn)
• Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten		<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung/Test/Einführung und von Produktverpackungen für alle Infineon/Qimonda Speicherkomponenten und -module (ca. 54 unterschiedliche Tray-, Tape & Reel- und ca. 22 unterschiedliche Module-Blistertrayverpackungen) - Entwicklung und Einführung von geräteübergreifenden Handlings-Materialien (Trägersteifen-, Substratmagazine, JEDEC-Trays,...) - Owner Verpackungsmaterialien und zugehöriger Material- und Designspezifikationen - Technisches Interface zu Herstellern für qimondaweite eingesetzte Verpackungsmaterialien (Trays, T&R, Barrier Bags,..) - Mitarbeit bei der Einführung von neuen Produkt Labeln und IC-Kennzeichnungen - Autor der Infineon/Qimonda „Produkt Marking Spezifikation“ (bis 2007) - Harmonisierung/Standardisierung der Infineon/Qimonda Verpackungslösungen - F&E Sprecher im Qimonda Verpackungsmaterialteam - F&E Sprecher im Produktionscluster Verpackung/Kennzeichnung - Qimonda Vertreter im globalen Infineon Spezialisten Team für Verpackung - Gutachter im Qimonda “Customer Request Team” für Verpackungsfragen - Gutachter für verpackungsspezifische Kundenreklamationen
• Datum (von – bis)		04/1996 – 08/2002
• Tätigkeitsbereich oder Branche		Backend Produktintegration, R&D für Packages und Memory Module

<p>• Beruf oder Funktion</p>		<p>Senior Engineer (Graduation für Fachexpertenlaufbahn)</p>
<p>• Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortlich für die Einführung von TSOP IC-Gehäusen in die Infineon BE-Produktion - BE-Projektleiter zur Einführung von neuen Speicherprodukten in die Endfertigung Dresden (BE-Vertreter in den jeweiligen 64M/128M/256M und 300mm-Wafer Entwicklungsteams) - Mitglied im globalen Infineon „BE-Cluster Process Board“ - Einführung/Owner des lokalen „BE-Process Change Board“ - Dresden Sprecher im globalen Infineon „Lead Frame“ Board - Einführung FMEA-Prozedur/Datenbank in die Endfertigung Dresden
<p>• Datum (von – bis)</p>		<p>04/1990-03/1996</p>
<p>• Tätigkeitsbereich oder Branche</p>		<p>Technologie Entwicklungen für die Endmontage (Backend) von integrierten Schaltkreisen (IC) und Chip on Board (COB)</p>
<p>• Beruf oder Funktion</p>		<p>Technologieverantwortlicher, Projektleiter</p>
<p>• Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Einführung des Subcontract Assembly von IC der ZMD GmbH (Subcons: Anam/Amkor, ASAT, Carsem, AME, ETSA,...Umfang: ca. 25 Gehäusebauformen, 7Mio IC/Jahr) - Technologieverantwortlicher „Chip and Board“ Technologie (DIMM, Sensors,PCMCIA..) - Owner “ZMD Assembly Design Rules” und „ZMD Package Guide”
<p>• Datum (von – bis)</p>		<p>11/1978-03/1990</p>
<p>• Tätigkeitsbereich oder Branche</p>		<p>Technologie und Gehäuseentwicklungen für die Endmontage (Backend) von integrierten Schaltkreisen (IC) in Plastik- und Keramikgehäusen</p>
<p>• Beruf oder Funktion</p>		<p>Entwicklungsingenieur, Komplexverantwortlicher</p>
<p>• Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Technologie Pilotfertigung für Plastik- und Keramik IC-Gehäuse - Technologieüberleitungen in Massenproduktion - Verantwortlicher für Entwicklung von Keramik IC-Gehäusen und deren Verarbeitung - Technologie-Projektleiter (Budget: 2Mio Mark/Jahr; 4-6 Ingenieure)

		<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeit / Prototyping für alle CMOS-Basistechnologien der früheren DDR Mikroelektronik (1 u. 4M DRAM, Mikroprozessoren, Herzschrittmacher, ASIC's,...) - Technischer Vertreter in den Regierungsabkommen mit der früheren UdSSR und CSSR zum Thema „Ceramic Packages for hermetic IC Packaging“ - Spezialist für IC-Keramikgehäuse im ehemaligen Kombinat Mikroelektronik - Mitarbeit an IC-Gehäusestandardisierungen (nationale und IEC-Standards)
• Datum (von – bis)		1974-1978
• Tätigkeitsbereich oder Branche		Glasformengießerei, Grauguss
• Beruf oder Funktion		Investitions-Ingenieur
• Wichtigste Tätigkeiten und Zuständigkeiten		<ul style="list-style-type: none"> - Investition Vorbereitungen (Genehmigungsverfahren, Projektdefinitionen, Landerwerb, ...) - Konzeption Elektro-Schmelzbetrieb und Qualitätsprüfung

Quellen-URL (abgerufen am 24.05.2012 - 04:31):

<http://www.interconomy.de/profil/c7lck3dfiq/mikroelektronik-packing-materials>